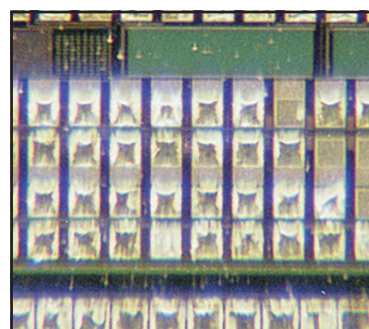
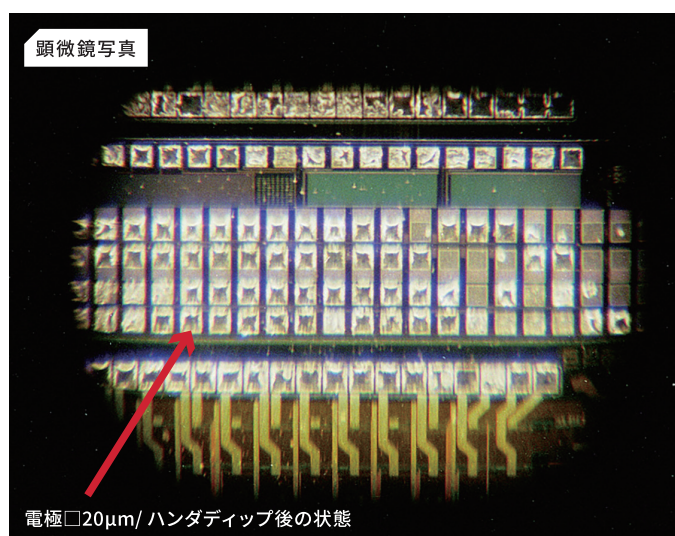




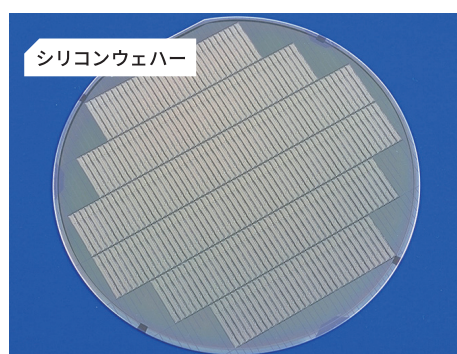
Application

Soldering ソルダリング

半導体ウェハー/
アルミ電極上への微細ハンダの一括ディッピング



綺麗な音エネルギーに共振したウェハーの表面からキャビテーションが発生し慣性や衝撃による破壊を伴わない静かな拡散接合



Point ここがポイント

- フラックスを使用しないマイクロハンダ付け(窒素雰囲気中)
- □20μm のアルミバンプ間にブリッジが発生しない狭ピッチハンダ付け
- 鉛フリーハンダやスズでも可
- ハンダの中での拡散接合で経時変化がない
- 綺麗な振動の効果でダメージがなく音波の排出作用でボイドが発生しない
- 残留応力がなくデンドライト(ウイスカ)が発生しない
- フラックスを使用しないために腐食などによる装置の故障が少ない
- ガス等の発生がなく環境に配慮したクリーンな作業環境

Product used 使用する装置

- CSS



AP-J-0106A4-2019102801